



株式会社バイ・テクノロジー
2025年3月期(第28期)

中間決算補足資料

(2024年4月1日～9月30日)

2024年11月11日

目次

- I. 概要
- II. 中間決算と業績予想
- III. 事業の状況
- IV. 中期経営計画(5/14公表)

I. 概要

(10百万円以下を切捨て)

- ① **中間連結決算は、売上高223億円(前期比+81%)、営業損失1.3億円(前期比+7億円)となりました。**
 - 半導体・フォトマスク装置事業: Q2(3か月)の営業利益は4.8億円の黒字となり、中間期の売上高は54億円(前期比+59.1%)、営業損失0.7億円(前年同期比+1.2億円)と、累損が縮小しました。
 - フラットパネル装置事業: Q2(3か月)の営業利益は4.4億円となり、中間期の売上高は162億円(前期比+92.5%)、営業利益1.0億円(前年同期比+6.5億円)と黒字化しました。
- ② **中間期の受注は175億円(前期比-14.2%)と想定をやや下回りましたが、商談等の状況から下期の回復を見込みます。**
 - 半導体・フォトマスク装置事業: シリコンウェハ、ラボ、及びフォトマスク向け装置が寄与し63億円(前期比-24.7%)となりました。
 - フラットパネル製造装置事業: 一部案件の受注計上が下期へ延伸し、受注高は104億円(前期比-8.9%)となりました。
- ③ **半導体・FPD共に事業発展の機会が多く、グループ技術を結集し、成長に向けた取組を加速します。**
 - 半導体・フォトマスク装置事業: 生成AI用のHPC製造技術の進化を背景に、レガシー半導体含む半導体全般の需要は中長期で増加トレンドにあると想定しています。同時に、当社グループが持つ技術や製品に対する国内外での引合は増えており、受注の増加、事業の成長を見込んでいます。
 - FPD装置事業: 設備市場について、OLED関連の投資が市場成長を牽引すると見込まれ、更なる製品の差別化およびコストダウンによるシェアの更なる拡大に加え、グループ技術を結集した新製品・新事業を成長分野で立上げ、売上規模の維持と収益性の向上を目指しています。
 - **具体的な内容につきましては、本資料の「II. 事業の状況」をご確認ください。**
- ④ **今期業績見通しおよび中期経営計画について、前回発表からの修正や変更は現時点でございません。**

今期業績予想について、利益がQ4にやや偏重する見込みですが、計画通りの着地を予想しています。

II. 中間決算と業績・配当予想

1. 連結業績
2. 主要事業セグメントの業績
3. 四半期売上・利益の推移
4. 地域別売上高
5. 販売費及び一般管理費
6. 貸借対照表
7. キャッシュフロー計算書
8. 受注・受注残の状況
9. 通期業績及び配当予想

1. 連結業績サマリー

売上増等により赤字幅は縮小

| (百万円) | FY24/3 中間(6か月) | FY25/3 中間(6か月) | 前年同期比 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 売上高 | 12,334 | 22,345 | + 10,011 + 81.2% |
| 営業利益(▲損失) (利益率%) | ▲880 — | ▲136 — | + 744 — |
| 経常利益(▲損失) (利益率%) | ▲592 — | ▲275 — | + 316 — |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益(▲損失) (利益率%) | ▲647 — | ▲218 — | + 429 — |

2. 主要事業セグメントの業績

(単位:百万円)

前年同期比、四半期比で増収増益

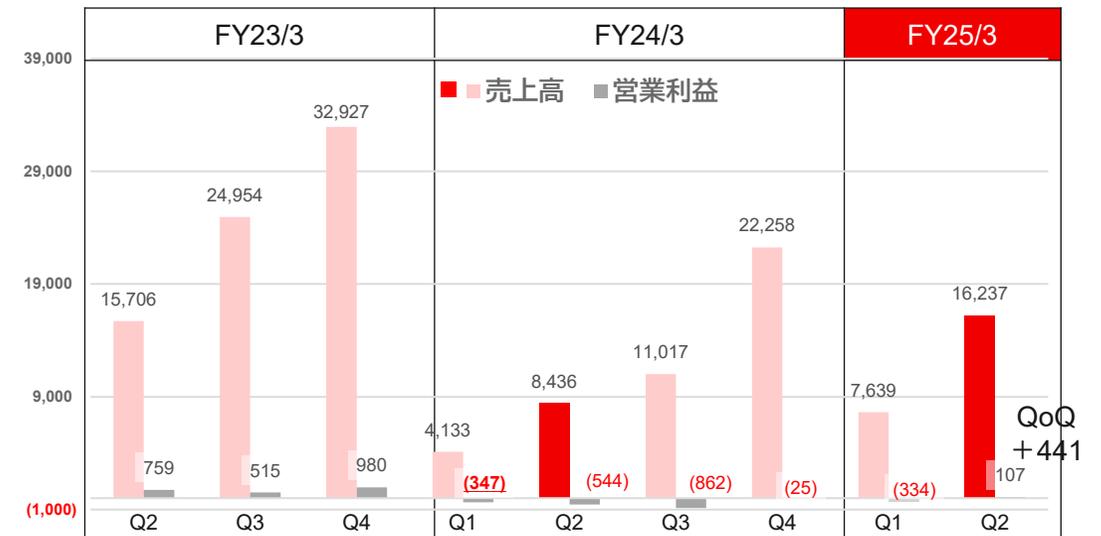
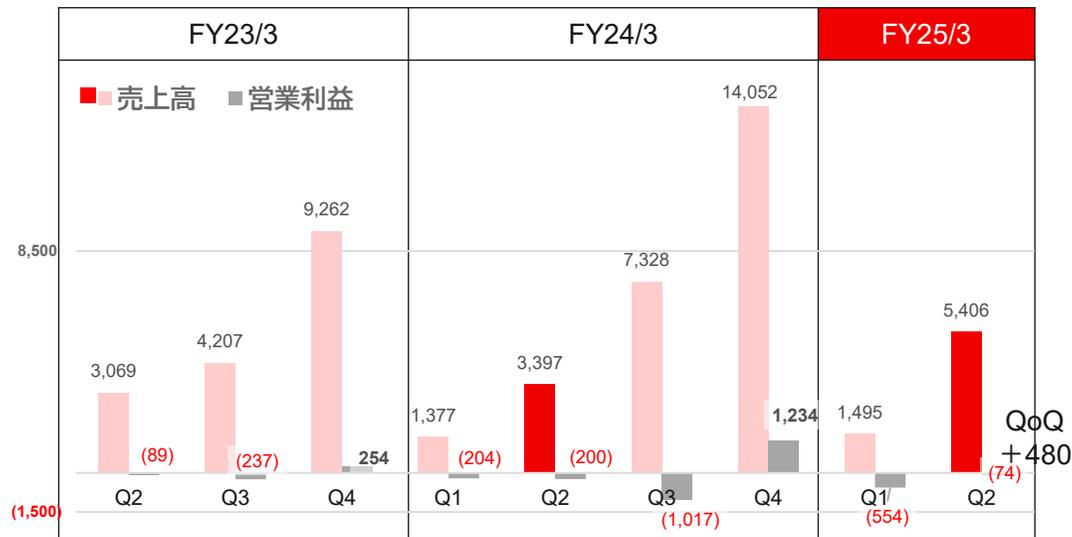
- ✓ 半導体・フォトマスク装置事業: フォトマスク・ウェハ・ラボ向け装置の販売が寄与し、Q2(3か月)の利益は480百万円
- ✓ FPD装置事業: 露光装置および測定装置の販売により、Q2(3か月)の利益は441百万円

半導体・フォトマスク装置事業

| | FY24/3 中間 | FY25/3 中間 | 前年同期比 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 売上高 | 3,397 | 5,406 | +59.1% |
| 営業利益(▲損失) (セグメント利益率) | ▲200 (-%) | ▲74 (-%) | +126 (-%) |

FPD装置事業

| | FY24/3 中間 | FY25/3 中間 | 前年同期比 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 売上高 | 8,436 | 16,237 | +92.5% |
| 営業利益(▲損失) (セグメント利益率) | ▲544 (-%) | 107 (-%) | +651 (-%) |

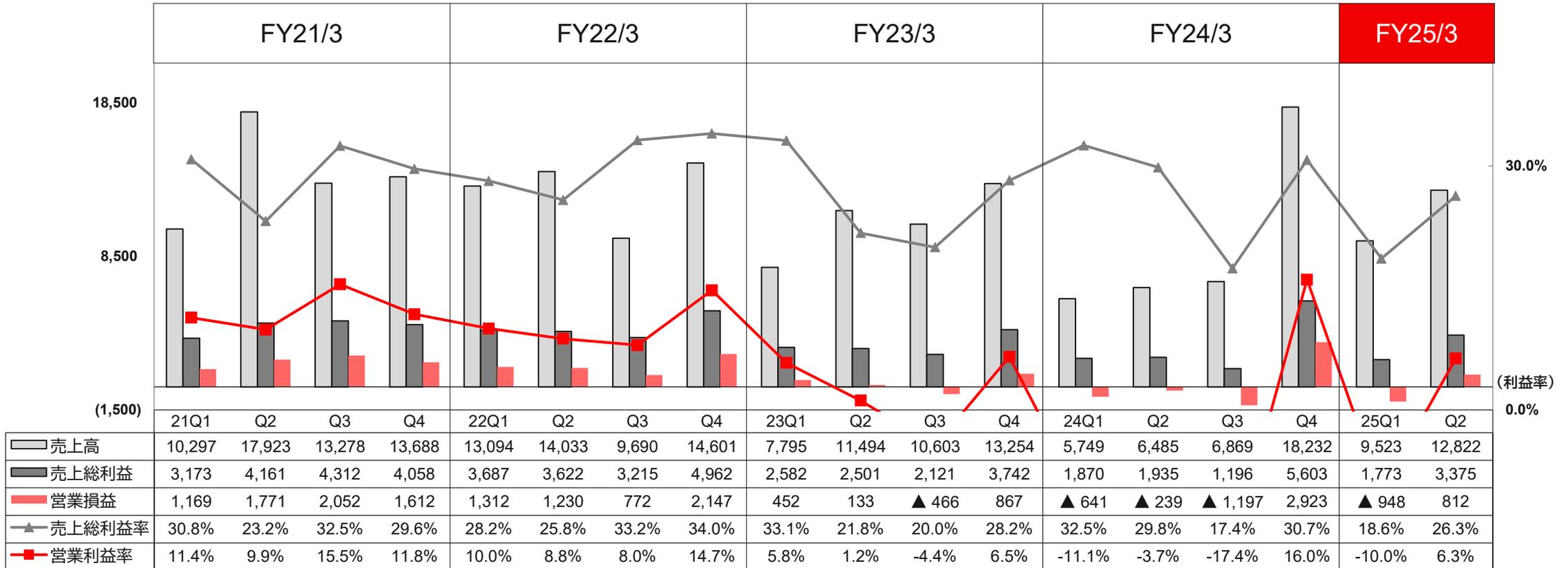


半導体・フォトマスク装置事業: 半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成
 FPD装置事業: FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成

3. 四半期売上・利益の推移

(単位:百万円)

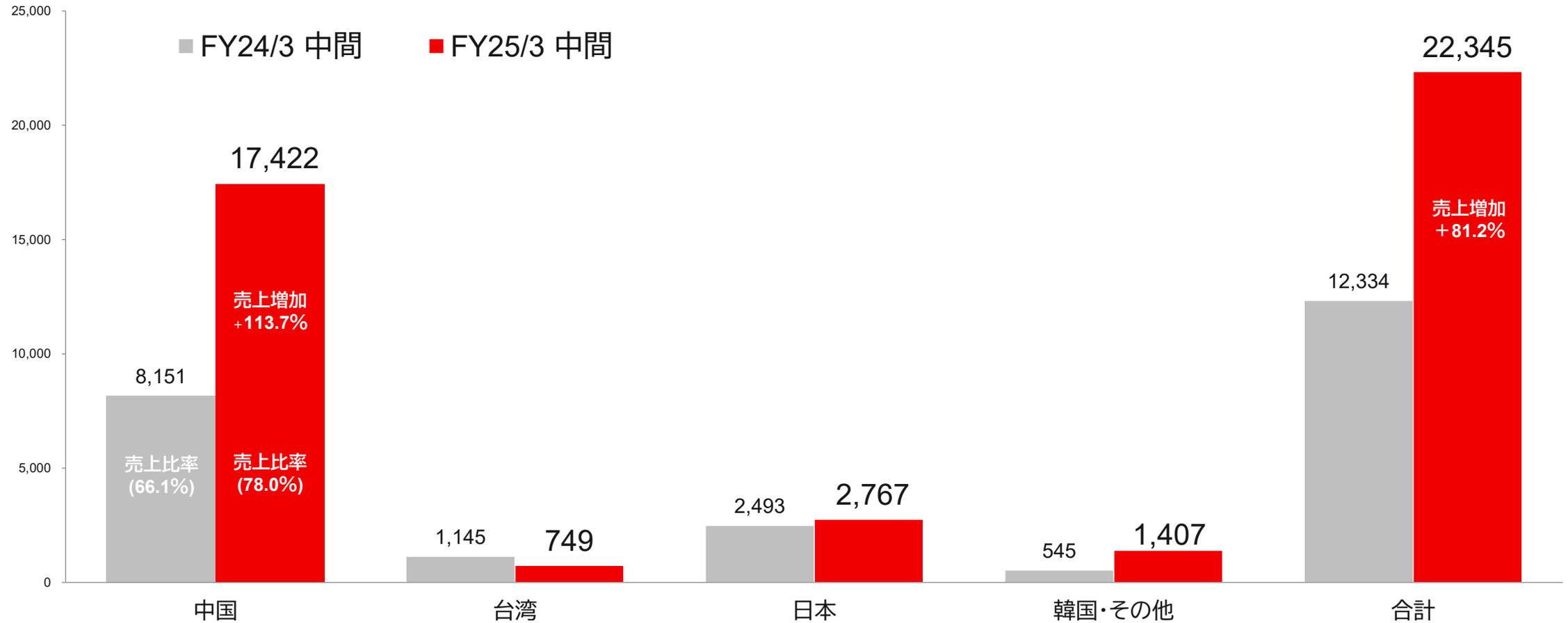
Q2収益は、売上増、プロダクトミックス改善等により黒字化



4. 地域別売上高

(単位:百万円)

主に、FPD装置事業の中国顧客向け販売が増加

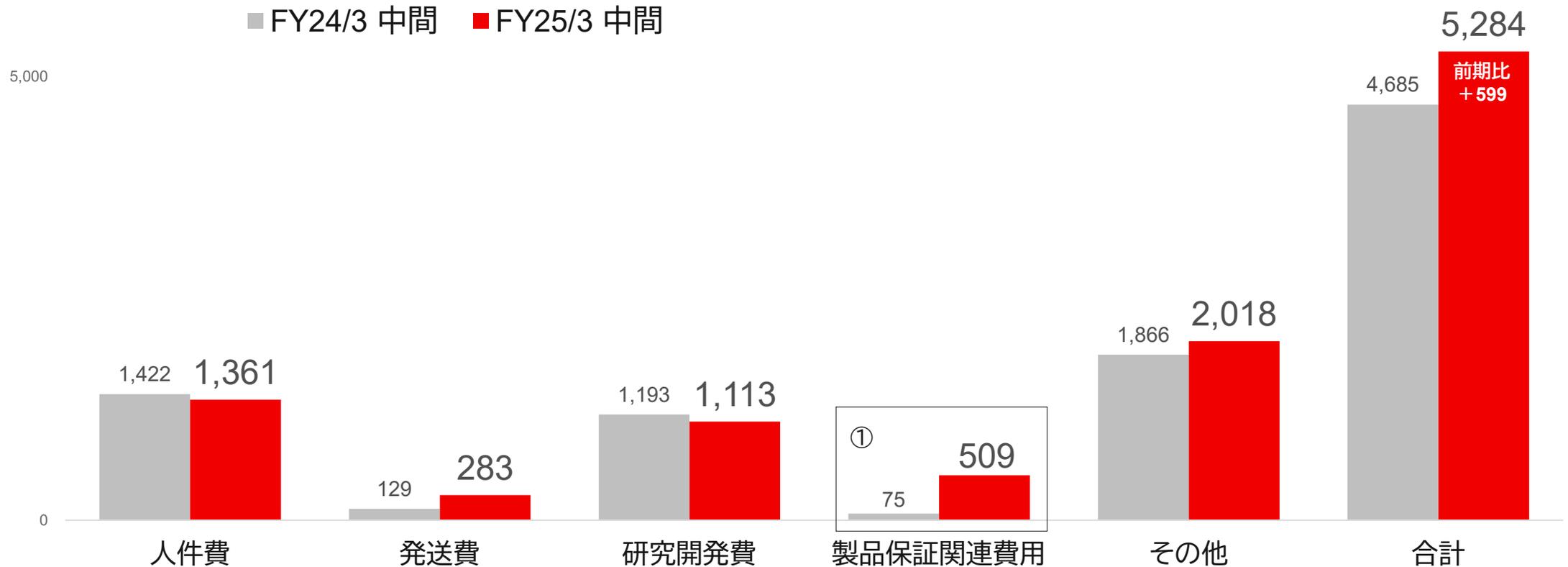


5. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円)

売上増に伴い、発送費および販売関連費等の変動費が主に上昇

① 前期は引当の戻入の影響から他項目より前期比差額が大きい(YoY+434百万円)



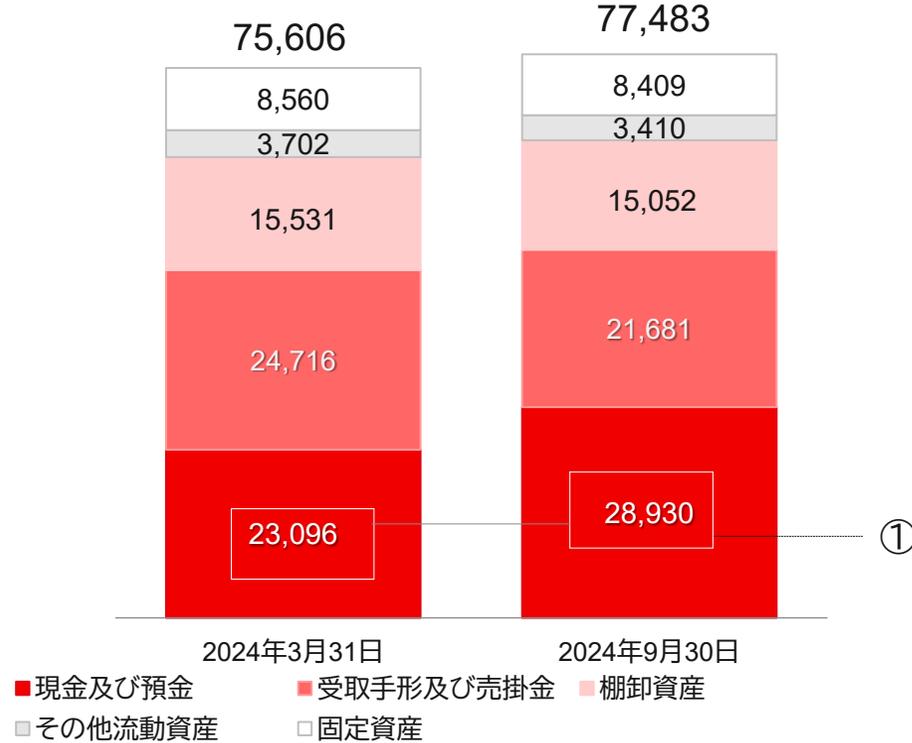
6. 貸借対照表

(単位:百万円)

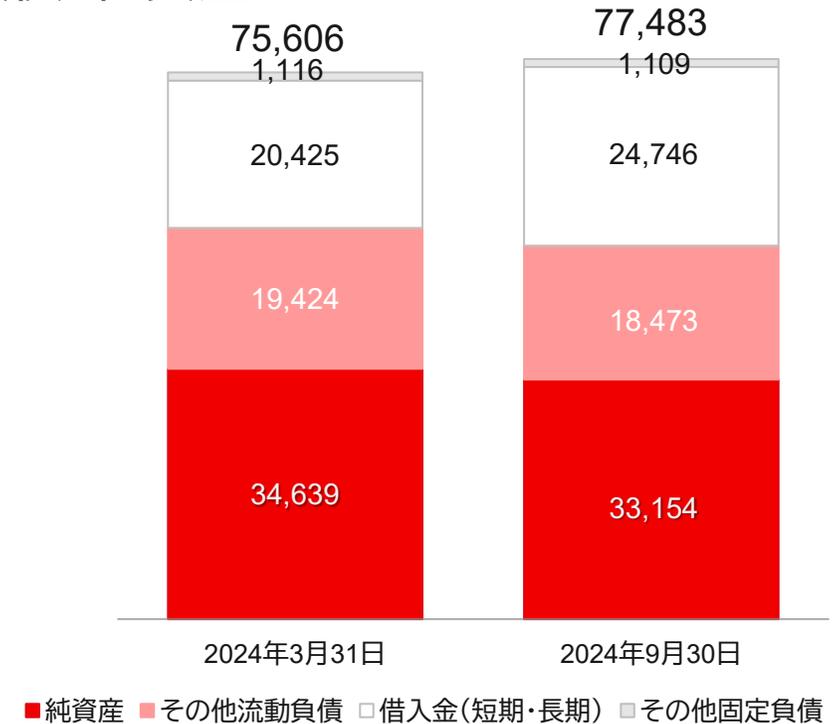
① 現金及び預金

✓ 売上検収作業の促進等による受取手形及び売掛金の減少、及び借入金が増加等により5,834百万円増加

総資産



負債・純資産



7. キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

前受金の増加、検収作業の促進等による売上債権等の減少により営業CFは+3,033百万円

| | | FY24/3 中間 | FY25/3 中間 |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 営業活動による キャッシュフロー | 税金調整前純利益(▲損失) | ▲570 | ▲217 |
| | 売上債権(▲増加) | 4,939 | 2,678 |
| | 棚卸資産(▲増加) | ▲4,761 | 544 |
| | 仕入債務(▲減少) | 2,182 | ▲1,720 |
| | 前受金(▲減少) | ▲3,726 | 1,147 |
| | その他 | 368 | 601 |
| | Total | ▲1,568 | 3,033 |
| 投資活動によるキャッシュフロー Total | | ▲418 | ▲747 |
| 財務活動による キャッシュフロー | 借入による収入 | 3,668 | 13,013 |
| | 返済による支出 | ▲3,758 | ▲8,750 |
| | その他 | ▲129 | ▲819 |
| | Total | ▲219 | 3,444 |
| 現金及び現金同等物に関わる換算差額 | | 173 | ▲110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(▲減少) | | ▲2,032 | 5,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 26,295 | 22,893 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | | 24,263 | 28,512 |

8. 受注・受注残の状況

(単位:百万円)

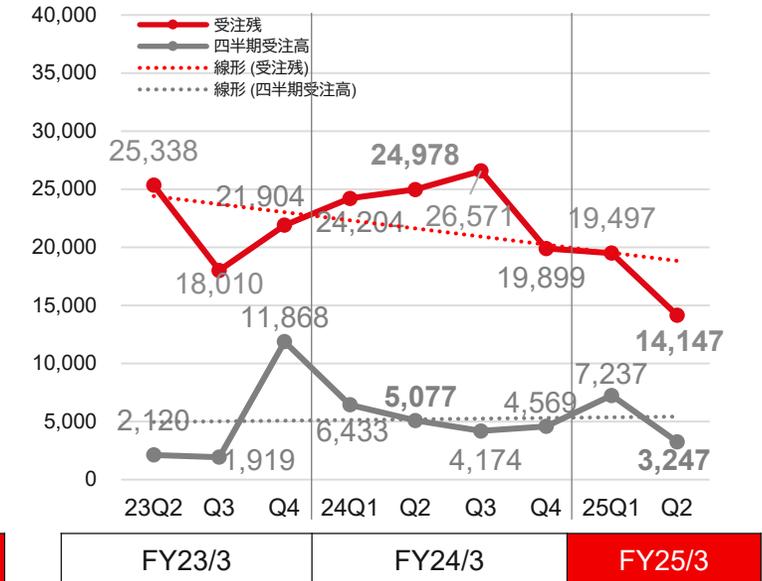
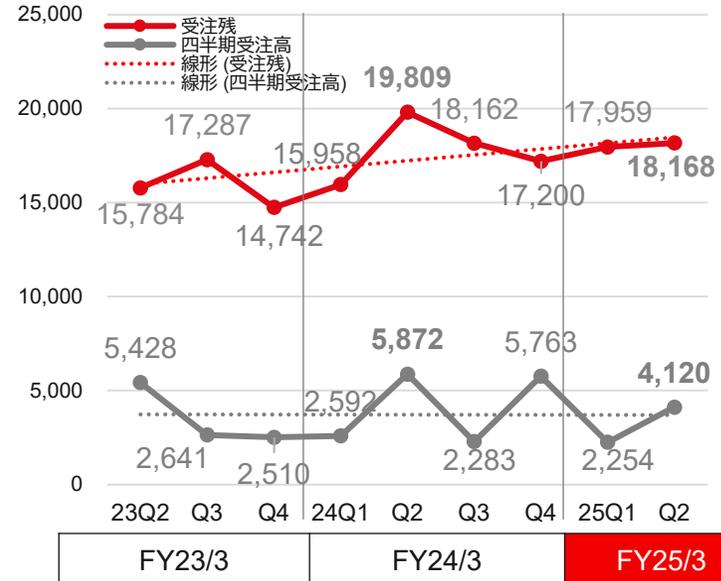
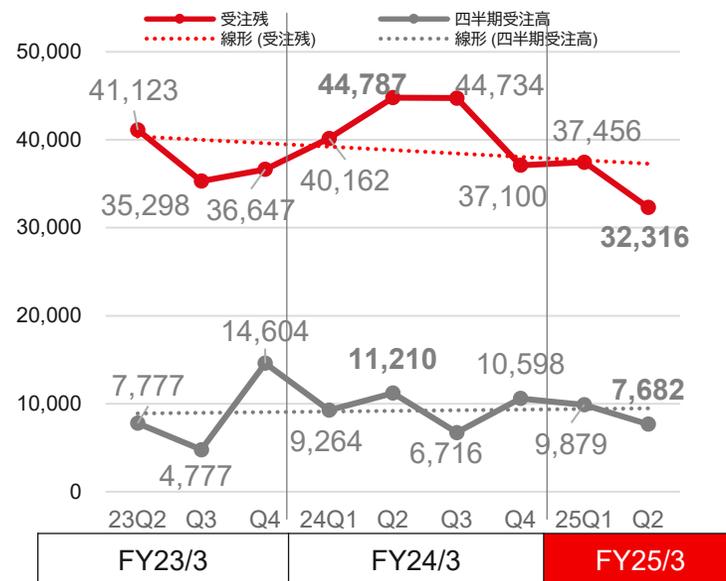
Q2受注は、FPD関連受注の延伸により停滞、下期からの回復を予想

- ✓ 半導体・フォトマスク装置事業・Q1からの延伸分が計上、ウェハやラボ用装置の受注が堅調、DIを中心に引合が増加傾向
- ✓ FPD装置事業………大型案件の発注手続きの遅れから想定を下回るが、Q3~Q4にかけての回復を想定

| グループ全体 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| | FY24/3 中間 | FY25/3 中間 | 前年同期比 |
| 受注残 | 44,787 | 32,316 | ▲27.8% |
| 受注高(累計) | 20,474 | 17,561 | ▲14.2% |

| 半導体・フォトマスク装置事業 | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| | FY24/3 中間 | FY25/3 中間 | 前年同期比 |
| 受注残 | 19,809 | 18,168 | ▲8.3% |
| 受注高(累計) | 8,464 | 6,374 | ▲24.7% |

| FPD装置事業 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| | FY24/3 中間 | FY25/3 中間 | 前年同期比 |
| 受注残 | 24,978 | 14,147 | ▲43.4% |
| 受注高(累計) | 11,510 | 10,484 | ▲8.9% |



9. 通期業績及び配当予想(1)

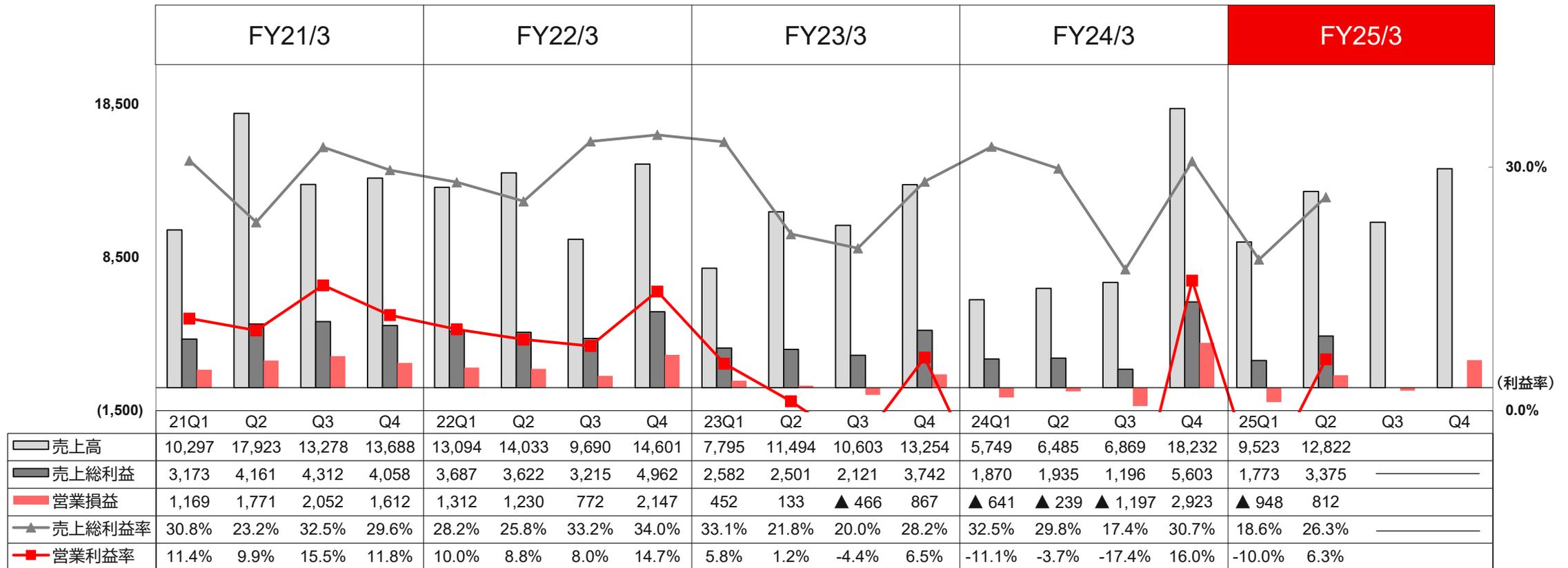
- 2024年5月13日開示の業績および配当予想からの変更は御座いません。
- 自己株式の取得により、EPSが変化しております。(前回103.90円→今回105.82円)

| (百万円) | | FY24/3実績 | FY25/3 業績・配当の予想 | |
|-----------------|----|----------|-----------------|--------|
| | | 金額 | 金額 | 前期比 |
| 売上高 | | 37,335 | 47,000 | +25.9% |
| 営業利益 | | 846 | 1,600 | +89.1% |
| (利益率) | | 2.3% | 2.5% | |
| 経常利益 | | 1,112 | 1,400 | +25.9% |
| (利益率) | | 3.0% | 2.1% | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 778 | 1,000 | +28.5% |
| (利益率) | | 2.1% | 1.4% | |
| EPS(円) | | 80.65 | 105.82 | +25.17 |
| 配当(円) | 中間 | 30 | 40 | +10 |
| | 期末 | 30 | 40 | +10 |

9. 通期業績及び配当予想(2)・・・下期見通し

(単位:百万円)

- 概ね、期初予想に沿った進捗となる見込みです。
- 第3四半期は、一部の案件についてQ4への延伸が見込まれ、当期Q2比で減収減益を予想しています。

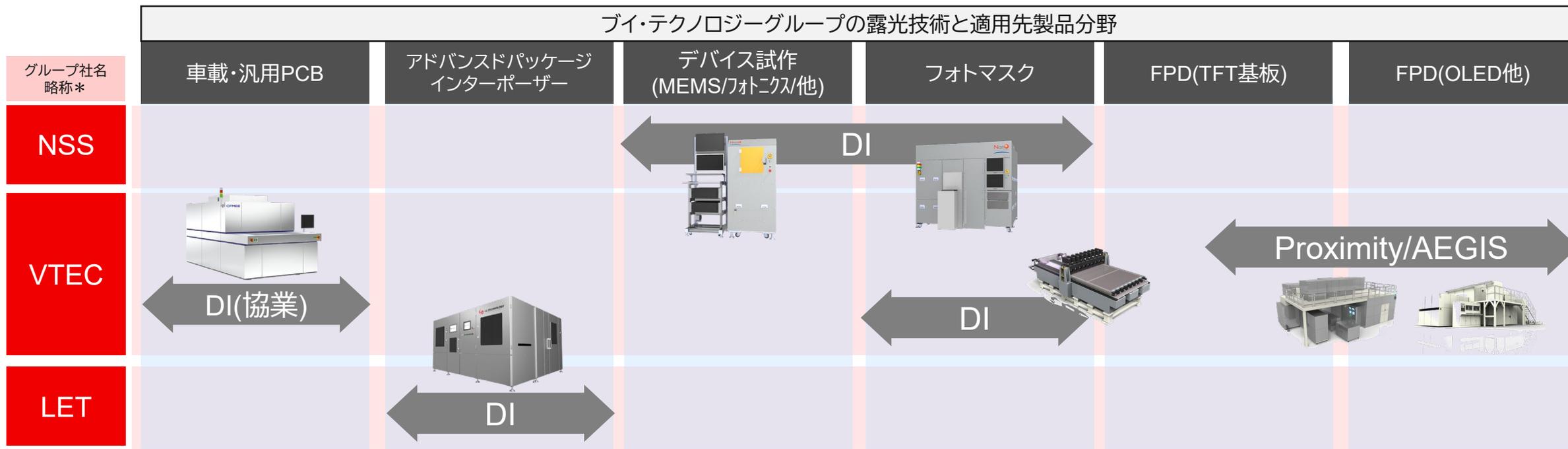


II. 事業の状況

1. 当社グループの露光技術の展開
2. 検査技術、成膜・洗浄技術の展開
3. 半導体パッケージ技術の進化と背景
4. パッケージ技術の進化と課題
5. 当社製品による課題の解決
6. シリコンウェハ製造およびラボ用装置
7. フォトマスク製造装置
8. フラットパネルディスプレイ製造装置、他

1.当社グループの露光技術の展開

- 新しい露光技術の開発・応用分野拡大を早期に実現する為に、グループの技術を結集し、取組みを強化
- 既存製品群は、電子デバイス分野の主要製品の製造工程をカバー(下図)

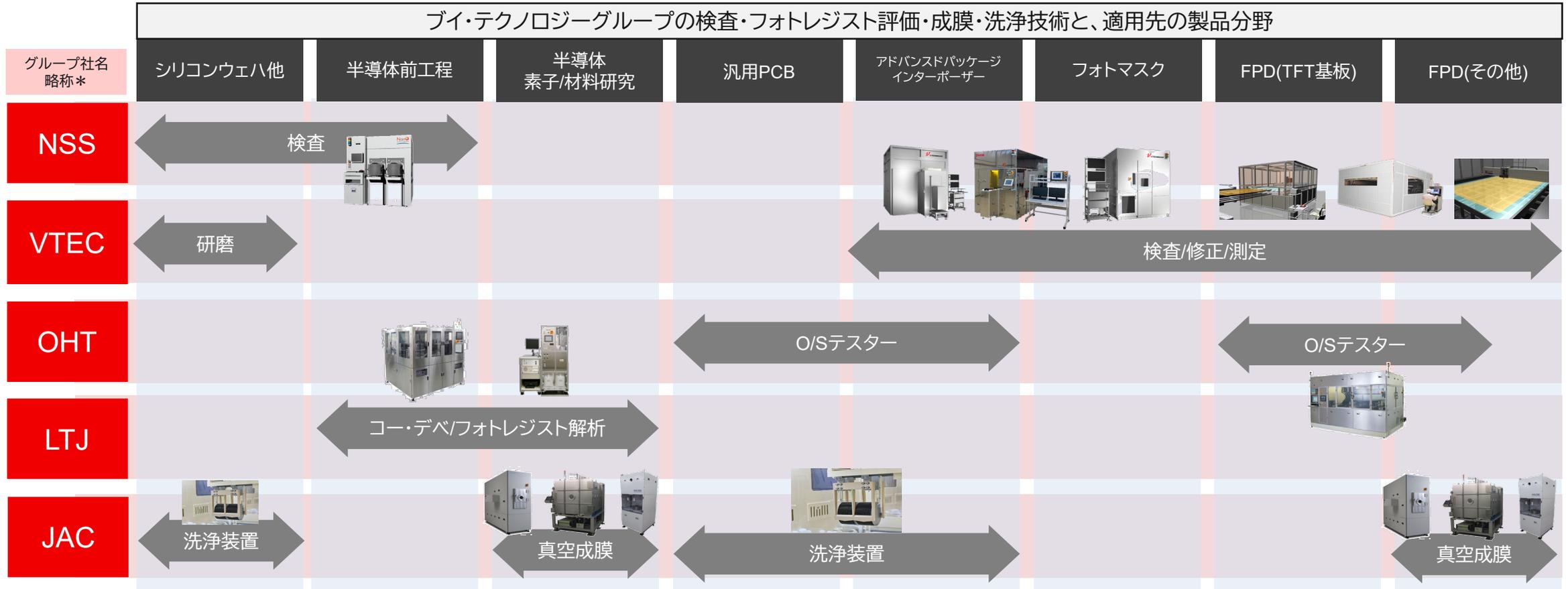


DI : Direct imaging、フォトマスクを使わず、CADデータ+レーザーダイオード+空間変調素子+専用光学系による直接描画
 Proximity : フォトマスクを露光対象にμm単位で近接させ露光
 AEGIS : 近接スキャニング露光

*会社名略称:
 NSS: ナノシステムソリューションズ
 VTEC: ブイ・テクノロジー LET: LE-TECHNOLOGY

2.検査技術、成膜・洗浄技術の展開

主要製品分野での多様な納入実績やネットワークを礎に、新しい分野・用途の製品開発を加速
 ✓ PLP、ダイシング、異種接合、他



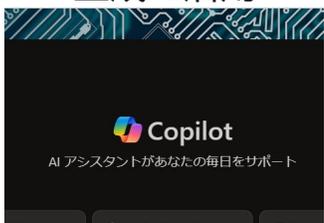
*会社名略称:

NSS:ナノシステムソリューションズ/VTEC:ブイ・テクノロジー/LET:LE-TECHNOLOGY/OHT:オー・エイチ・ティー/ LTJ:リソテックジャパン/JAC:ジャパンクリエイト

3.半導体パッケージ技術の進化と背景

高度デジタル技術

生成AI活用



自動化/IoT活用

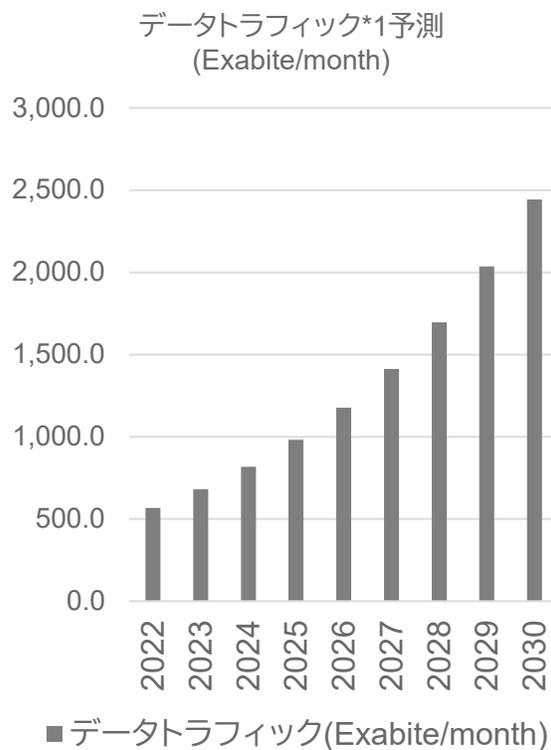


コンテンツ

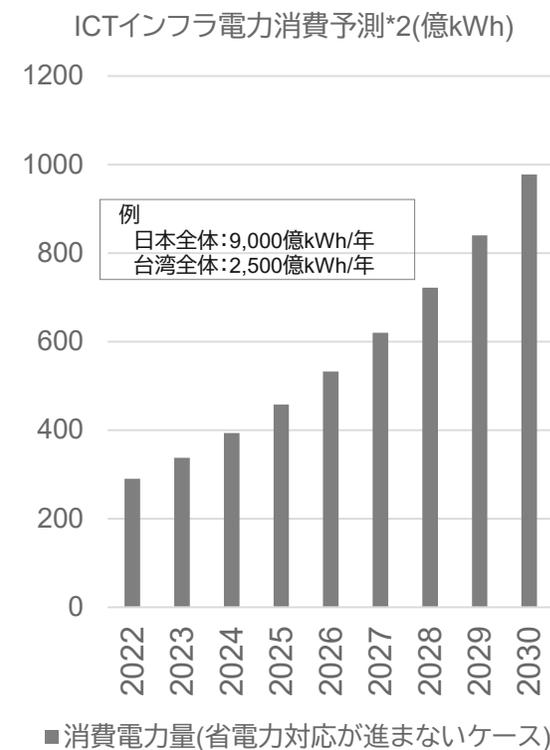


情報量と消費電力量は増加傾向

急増するデータへの対応



消費電力抑制が急務



半導体の進化

高速処理+省電力

トランジスタをより多く、より効率的にチップ(パッケージ内)に配置・接続する技術

≫微細化技術 (More Moore)
→EUV露光

≫パッケージ技術 (More than Moore)
→チップレット (ヘテロジ-ニアスパッケージ)
(2.5D、3D実装)

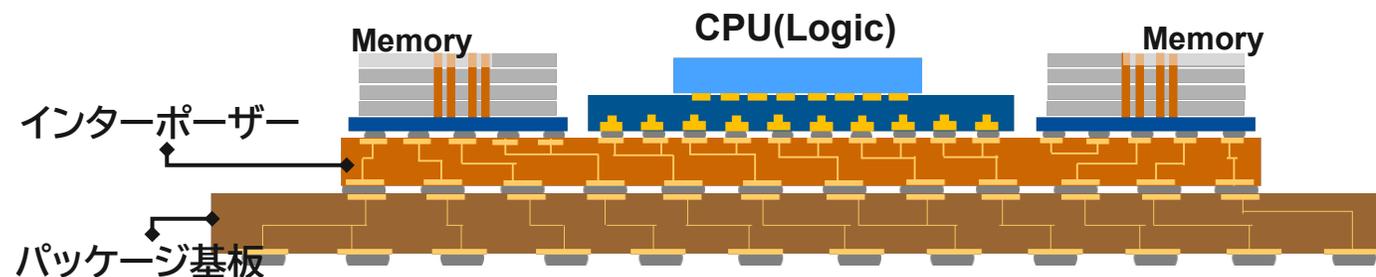
*1:NOKIA Global Network Traffic Reportより当社にて作成

*2:国立研究開発法人科学技術振興機構 情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響Vol4/Vol5資料より当社にて作成

4.パッケージ技術の進化と課題

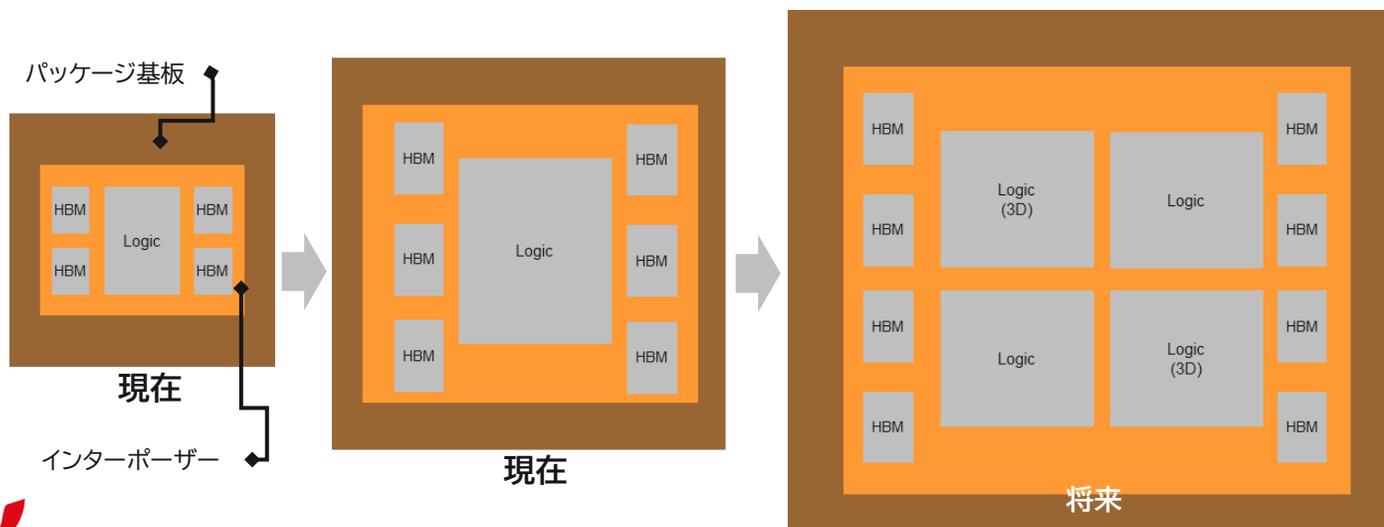
Known Good Substrate(予め良品と確認されたパッケージ基板・インターポージャー)の安定供給

ヘテロジーニアスパッケージ(各種半導体をインターポージャーで接続)



HPC進化→ヘテロジーニアスパッケージ、現在と将来イメージ*

搭載半導体の増加に伴う大型化と多層化……構成部材の良品管理の重要性UP



樹脂インターポージャー製造工程例

- ① ガラス基材受入れ
 - ② インターポージャー材料塗布
 - ③ シード層塗布
 - ④ フォトリソグレイブ
 - ⑤ 露光・現像・エッチング
 - ⑥ メッキ
 - ⑦ レジスト除去
- ②～⑦を複数回繰り返した後に剥離等の後、完成

課題

KGSSの安定供給

- ・基板変形の影響 (反り、ゆがみ、他)
 - » 繰り返す度に基板に変化発生
- ・変化による回路の断線

*:SB証券、他資料より当社にて作成

5.当社製品による課題の解決

- LAMBDI/IMAGINA : 製造中の基板の変化に対応する高タクト・高精度位置精度な露光を実現、3号機を受注、引合急増
- LIBRA : インターポージャーおよびパッケージ基板の端子間導通検査を世界で初めて実現、受注間近

HPC用ICパッケージ基板露光



DI露光装置
IMAGINA(イマジナ)

狭ピッチ端子間の電気検査

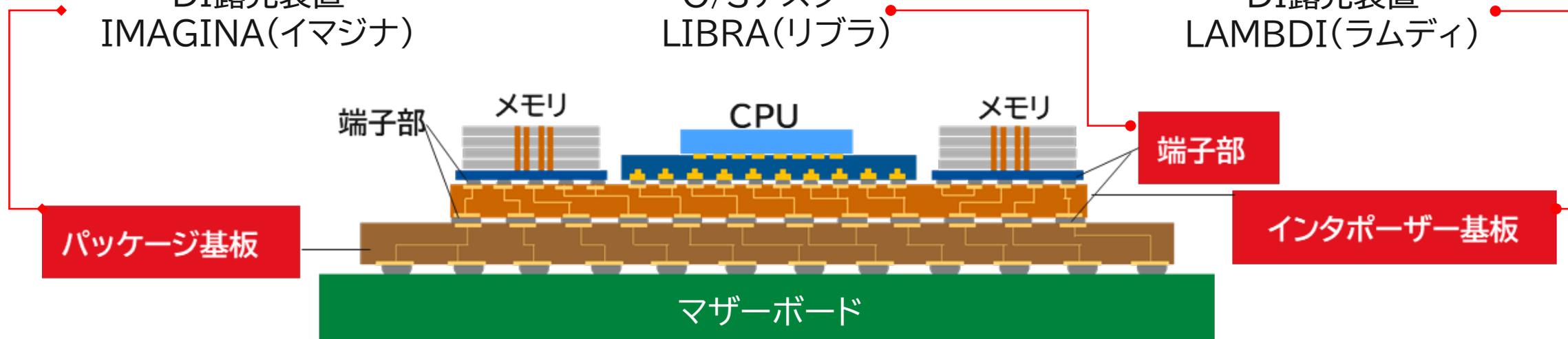


O/Sテスター
LIBRA(リブラ)

インターポージャー基板露光



DI露光装置
LAMBDI(ラムディ)

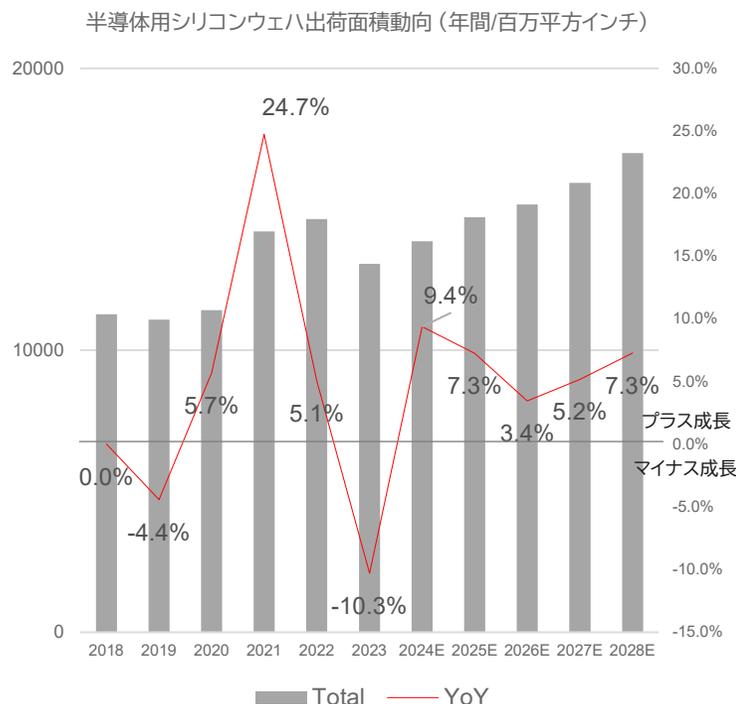


6.シリコンウェハ製造およびラボ用装置

- シリコンウェハ :高性能半導体向けのシリコンウェハ検査に対応する新製品の投入を継続
- ラボ用製品(材料開発他):各種材料の開発に、きめ細かく対応できる実験用装置・機器の提供を継続

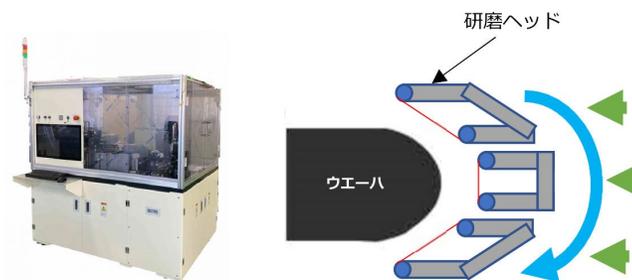
半導体用シリコンウェハ出荷トレンド予測*1と、グループ技術

足元はAI関連需要から回復基調、長期的な半導体需要増からウェハ生産の成長は継続



インテリジェントエッジ研磨装置

難削材化合物半導体のエッジ部を高効率研磨



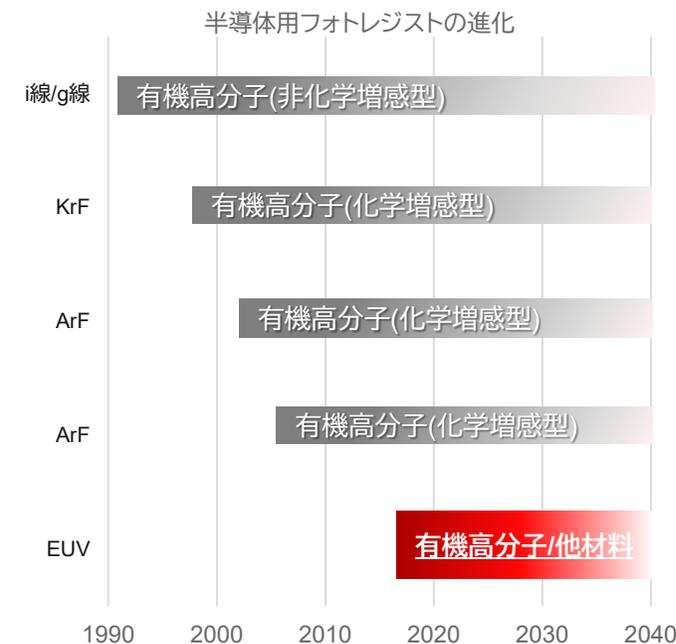
超小型研磨ヘッド使用 (特許出願済)

定点研磨動作 (◀)・連続研磨動作 (▶)

独自研磨テープ使用

半導体用フォトレジストの進化*2

活発化する半導体用材料開発
(前・後工程・PKG工程用各種材料等)

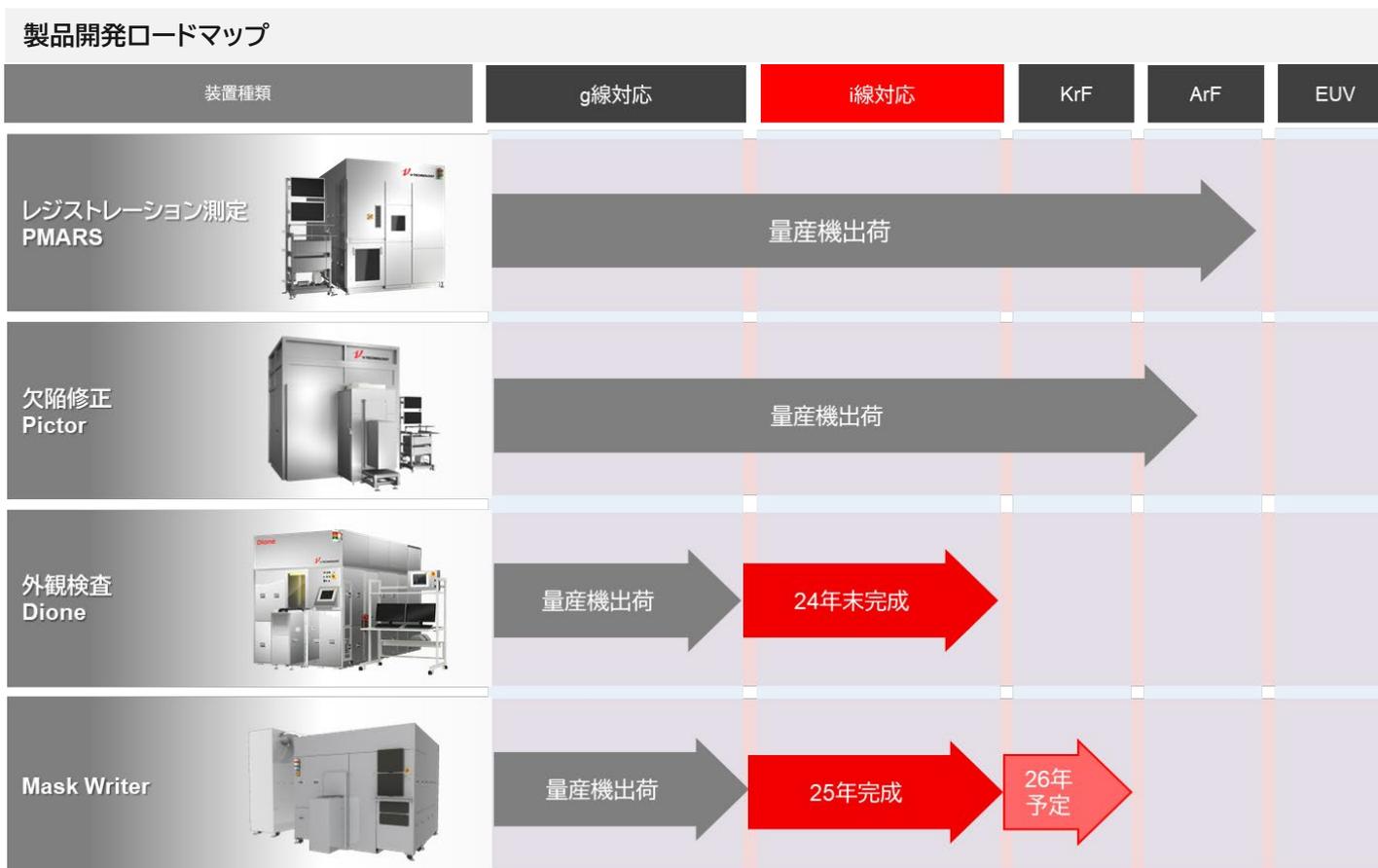


*1: SEMI「Silicon Shipment Statistics」およびOMDIA社資料より当社にて作成
*2: 日経XTECH記事、他、各社資料を参考に当社にて作成

7.フォトマスク製造装置

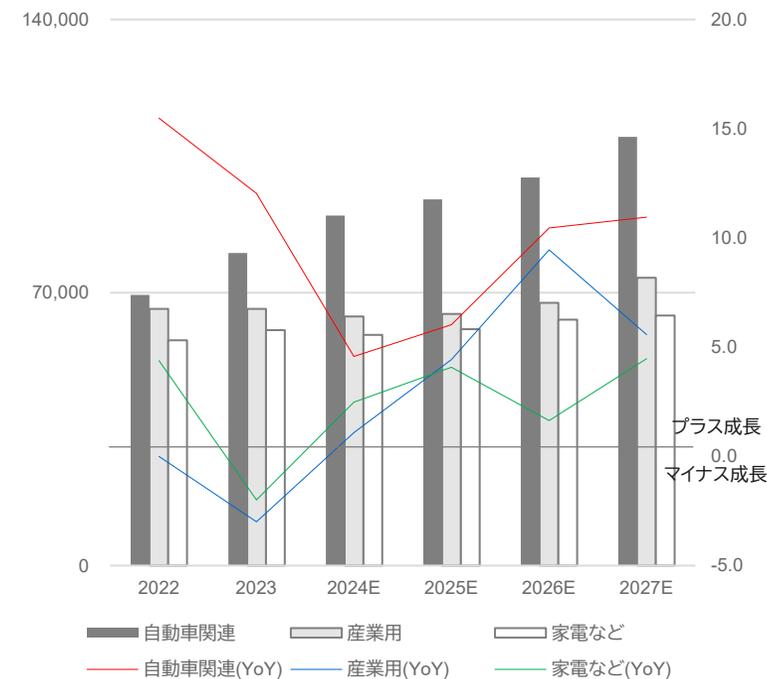
g線/i線フォトマスク関連装置の需要は、安定的に推移する見通し……各波長に対応する製品を順次投入

- ✓ 1990年代に納入されたg線/i線用装置(半導体およびFPD)の継続的な置換需要
- ✓ GX等を背景としたパワー・車載半導体需要の中長期の成長(2024年は調整)、
- ✓ IT及びゲーム用モニター、タブレット、ノートPC、AR/VRディスプレイへのOLED採用増



自動車・産業・家電用半導体市場(金額)と成長率の推移*

2023年を底に、自動車向けが成長を牽引

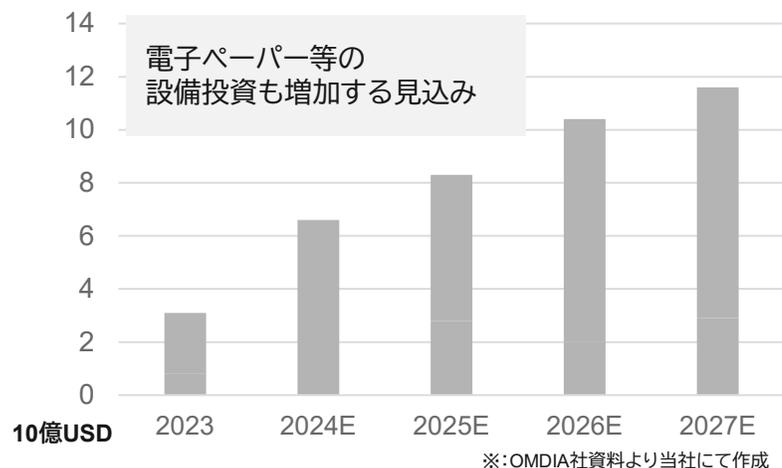


*: OMDIA社資料より当社にて作成

8.フラットパネルディスプレイ製造装置、他

- 差別化やコストダウンによるのシェアの更なる拡大
- 成長分野での収益機会の獲得に向け、グループ技術を結集し開発した新製品を投入

FPD設備市場(金額)推移 ※



事業環境

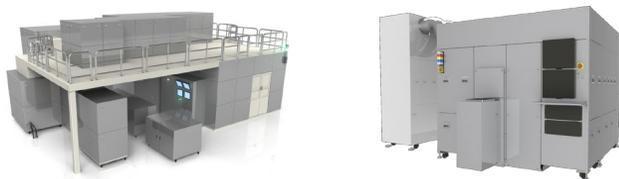
- OLED関連投資の増加(G8有機EL工場)
- 中国景気刺激策(家電下取りプログラム、金融緩和)
- 大型LCDパネル生産の中国一極集中、インドにおける大型パネル工場投資計画

用途/分野ごとの基本方針

| LCD/装置*1 | OLED・TFT/装置 | OLED/蒸着マスク | OLED/再生事業 |
|--|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •差別化 •コスト競争力強化 →現地生産・基幹部品内製 | <ul style="list-style-type: none"> •左記 •新製品*2の市場投入 | <ul style="list-style-type: none"> •スマホ向け •AR/VR(廉価版)向け →高位置精度FHM*3 | On site Salvage |

*1 露光装置の新展開

- 電子ペーパー関連の設備投資(中国・台湾)



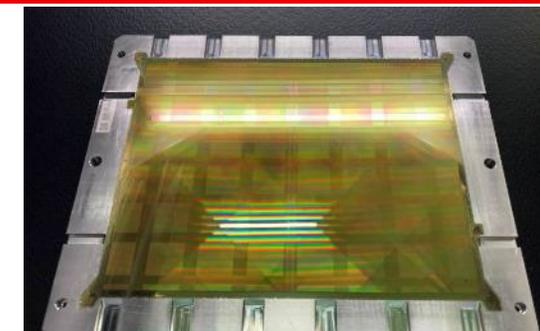
カラーフィルター露光装置、マスクレス露光装置の電子ペーパー展開

*2 OLED用新型テスター

- 画像検査で難しい微細回路の検査を実現
- OLED向け超高解像度センサー搭載
- 位相検波方式を採用した新たなOLEDテスト搭載



*3 高位置精度蒸着マスク(Fine Hybrid Mask)



Ⅲ.中期経営計画(5/14公表)

1. 中期経営計画(2024年5月公表)・・・数値目標

事業環境および諸施策の進捗等より、変更なし

| 指標等 | 24年3月期 (実績) | 数値目標 | | | |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 25年3月期 | 26年3月期 | 27年3月期 | 29年3月期 |
| 売上高(億円) | 373 | 470 | 570 | 670 | 1,000 |
| 内、半導体・フォトマスク装置事業 | 140 | 225 | 316 | 358 | 680 |
| 内、FPD装置事業 | 223 | 230 | 230 | 280 | 250 |
| 内、新規事業 | 10 | 15 | 24 | 32 | 70 |
| 営業利益(億円) | 8.5 | 16.0 | 45.0 | 74.0 | 200.0 |
| 営業利益率 | 2.3 | 3.4 | 7.9 | 11.0 | 20.0 |
| **ROE (%) | 2.3 | 2.9 | 8.2 | 12.5 | 23.7 |

*ROEは、為替影響を織り込んでおりません。

・ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

お問い合わせ先

社長室 IRグループ
vtj-mng-pre@vtec.co.jp

